



2026年3月19日

各 位

会社名： シンデン・ハイテックス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 鈴木 淳
(コード番号：3131)
問合せ先： 常務取締役(管理本部管掌) 田村 祥
(フリーコール：0800-5000-345)

資金の借入に関するお知らせ

当社は、下記のとおり資金の借入を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入の目的

当社は、昨今の半導体・電子部品市場、とりわけメモリー市況の変動等を背景とした調達環境の変化に対応するため、安定的な事業運営および供給体制の確保を目的として、資金の借入を行うことといたしました。

2. 借入の概要

(1) 借入先	国内金融機関複数行
(2) 借入金額	総額 80 百万米ドル (上限)
(3) 借入実行日	2026年3月26日 以降順次
(4) 借入期間	1か月～1年以内、返済期限にて再借入あり
(5) 借入利率	変動金利＋スプレッド
(6) 返済方法	期限一括返済
(7) 担保の有無	無担保
(8) 資金使途	運転資金

3. 今後の見通し

本借入が2026年3月期の連結業績に与える影響につきましては、現時点において軽微であります。今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上